

# Edge Protection Technology

## EDGE PROTECTION TECHNOLOGY CONSIDERATIONS

Amkorのパッケージ保護技術が、テストおよび組立や搬送中のMLF®パッケージのエッジを保護します。

## ADVANTAGES

- ▶ 強化されたパッケージエッジ
- ▶ テスト起因のダメージを低減
- ▶ ハンドリング時の損傷を低減
- ▶ パッケージ面積の変更なし

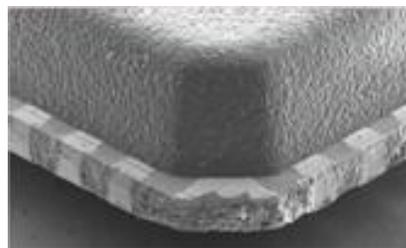
Amkorは、MLF®パッケージの堅牢性をさらに向上させるため、テストや表面実装（surface mount assembly : SMA）などのハンドリング中にデバイスのエッジを保護するEdge Protectionテクノロジーを開発しました。

AmkorのMicroLeadFrame®パッケージは、1990年代の量産開始以来、サイズ面での利点、堅牢な品質、およびウェットプルフラック構造により、自動車産業での採用が加速しています。Amkorは、MLFパッケージを、自動車業界の厳しいアプリケーションニーズに対応するソー（Saw）タイプとパンチ（Punch）タイプで提供し、自動車業界向けQFNパッケージの最初のサプライヤーとして認知されています。

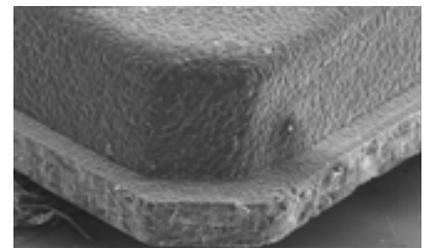
Amkorは、自動車アプリケーションの課題に対応する高品質QFNパッケージングソリューションのリーディングカンパニーとして、MLFパッケージングソリューションの機能や能力を拡大する為の開発を続けています。実績あるディンプルエンドリード技術により、パンチタイプのMLFは自動車アプリケーションの選択肢として引き続き採用されています。

Amkorの革新的なEdge Protection Technologyは、パッケージデザインの堅牢性を向上させるため、特にテスト分野で急速に採用が拡大しています。パンチタイプのMLFパッケージのエッジを強化することにより、テスト時のダメージが大幅に減少しました。

Amkorは現在、様々なボディサイズのEdge Protectionテクノロジーを備えたパンチタイプMLFパッケージを提供しています。



Edge Protectionなし



Edge Protectionあり

詳細については[amkor.com](http://amkor.com)にアクセス、  
または[sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) までメールをお送りください。



本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはそのライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved.  
TS112A-JP Rev Date: 9/18



詳細については[amkor.com](http://amkor.com)にアクセス、  
または[sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) までメールをお送りください。

本文書中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved.  
TS112A-JP Rev Date: 9/18